附件1：

半导体所保健津贴的工作类别标准

一、一类保健津贴的工作类别

（一）非放射性工作

1．专职从事有机及高分子合成工作（经常接触使用剧毒物质）

2．专职从事化学化工研究和生产工作，经常接触使用剧毒物质或强致癌物质

3．专职有氰电镀工作

4．半导体气相、液相砷外延

5．离子注入机掺杂工作

6．氧化铍开放性热加工工作

7．从事高能量大功率激光器的研制

（二）放射性工作

1．在开放型放射实验室中工作，每月经常操作下列辐射水平人员：

（1）极毒性≥1.85×106Bq（即0.05mCi）

（2）高毒性≥1.85×107 Bq（即0.5 mCi）

（3）中毒性≥1.85×108 Bq（即5 mCi）

（4）低毒性≥1.85×109 Bq（即50 mCi）

即等效操作量在1.85×107 Bq（即0.5 mCi）

2．放射性工作人员月累积剂量达1mSv（即100mrem）

3．操作高压大功率（工作电压42kV，电流50MA）离子注入机人员

二、二类保健津贴的工作类别

（一）非放射性工作

1．专职从事化学分析或在化学、生物化学和其它科研工作中经常使用高毒物质或接触使用致癌物质的工作

2．半导体扩散、光刻、制版、外延以及减薄工艺

3．光电器件制网、制靶、制版、蒸靶

4．拉单晶

5．晶体生长工（水溶液晶体生长享受三类保健津贴）

6．阴极、热子研制工（包括光电阴极）及荧光屏研制

7．等离子溅射、腐蚀、焊接、切割

8．电镜操作工（经防护后在操作位置上月累积剂量1mSv，即100mrem以上者可享受一类保健津贴）

9．电子束焊接、曝光、蒸发

10．微波功率源研制测试及雷达发射（辐射大于50µW／cm2）

11．高频感应加热（电场强度大于100V／m）

12．研制有毒染料介质激光器或大功率（包括固体气体）准分子激光器（平均功率大于50W或可见光激光器功率大于5W）

13．从事光学玻璃材料熔炼和配料、清洗腐蚀及退火工

14．加工碘化物、砷化镓晶体及特种光学玻璃（含砷、铅、锑磷酸盐）

15．强磁场实验（高于11万Gs）

（二）放射性工作

1．在开放型放射实验室工作，每月经常操作下列辐射水平的人员：

（1）极毒性≥3.7×104Bq（即1µCi）

（2）高毒性≥3.7×105 Bq（即10µCi）

（3）中毒性≥3.7×106 Bq（即100µCi）

（4）低毒性≥3.7×107 Bq（即1000µCi）

即等效操作量在3.7×105 Bq（即10µCi）以上

2．经常操作密封放射源的工作人员：

（1）携带式辐射源＜1.85×109 Bq（即50mCi以下）

（2）固定式辐射源≥3.7×1011 Bq（即10 Ci以上）

（3）操作强度≤107中子／秒同位素中子源

（4）操作≤3.7×108 Bq（即10mCi以下）镭源

（5）β源≥3.7×106 Bq（即100µCi）

3．专职剂量监测人员（兼职人员享受三类保健津贴）

4．专职从事X光机、放射线X、γ探伤仪和X光衍射仪的操作人员

5．放化实验室专职检修人员

6．放射性物理化学分析人员

7．经常使用固定辐射源（1000Ci以上）的科研实验人员

三、三类保健津贴的工作类别

（一）非放射性工作

1．在科研工作中，经常使用中毒物质或大量使用低毒物质的工作

2．专职从事一般化学分析，经常接触使用中毒物质的工作

3．专职从事药材加工等接触粉尘严重的工作

4．砂轮切割工，工具磨工

5．电气焊工，氢炉焊接工，电火花加工

6．真空镀膜（使用高毒物的享受二类保健津贴）

7．非金属材料（陶瓷、晶体、岩石、玻璃等）研磨、切割、抛光

8．磁性材料制备、生产

9．化学药品仓库保管员（量大品种多，同时进行分装回收可享受二类保健津贴）

10． 35kV动力变电工

11．微波管流程、装焊工

12．力学的疲劳、振动、断裂试验

13．操作塑料注射机及专职塑料焊接工

14．研制小功率激光器或一般使用激光器

15．微波测试工作（辐射20~50µW／cm2）

16．高频装置操作工（电场强度大于20V／m）

17．专职去离子水的生产工

18．光学玻璃胶合、刻划、测试工

19．半导体工艺压焊、打印工以及专职从事电子线路板铅焊工

20．专职下水道工、专职司炉工（直接接触煤尘作业和高温条件）

21．在大于90dB（A）的噪声条件下（脉冲噪声除外）工作的人员

22．专职从事一般化学分析，经常接触使用大量低毒物质

23．空调维修工（氨气设备可享受二类保健津贴）

24．视觉电生理实验

25．光机装校工

26．从事低温制冷（液氮、液氦等）工

27．封闭式空调机房内专职计算机工作人员

28．图书资料档案库专职保管人员

（二）放射性工作

1．在开放型放射实验室工作，每月经常操作下列辐射水平的人员：

（1）极毒性＜3.7×104 Bq（即1µCi）

（2）高毒性＜3.7×105 Bq（即10µCi）

（3）中毒性＜3.7×106 Bq（即100µCi）

（4）低毒性＜3.7×107 Bq（即1000µCi）

即等效操作量在3.7×105 Bq（即10µCi）以下

2．从事密封放射源操作的人员：

（1）携带式辐射源≤1.85×108 Bq（即5mCi）

（2）固定式辐射源＜3.7×1010 Bq（即1Ci）

（3）β源＜3.7×106 Bq（即100µCi）